

FINEPLACER® micro hvr

Automatische Heißgas- Reparaturstation für hohe Stückzahlen



FINEPLACER® micro hvr

Der kosteneffiziente FINEPLACER® micro hvr bietet vollautomatisierte Prozesse kombiniert mit außergewöhnlicher Anwendungsflexibilität.

Das preisgekrönte System kommt vor allem in Produktionsumgebungen mit Fokus auf hohem Ertrag zum Einsatz.

Highlights*

- Bauteile von 0,25 mm x 0,25 mm bis 90 mm x 80 mm
- Boardgrößen bis 350 mm x 260 mm
- Geregelte Kraftkontrolle
- Vollautomatisierte Bedienung und Lötprozesse
- Präziser, verschleißfreier xy- Positioniertisch
- Traceability- Unterstützung durch offene Schnittstellen- Struktur
- Flexibel und kosteneffizient
- Platziergenauigkeit von 10 µm @ 3 sigma

* je nach Konfiguration

Merkmale

- Automatische Bilderkennung, automatisches Ausrichtung und Löten
- Overlay Vision Alignment System mit festem Strahlteiler
- Integriertes Prozessmanagement (IPM)
- Adaptive Prozessbibliothek
- Kamera für die Live- Prozessüberwachung

Vorteile

- Vollautomatische, anwenderunabhängige Prozessführung
- Herausragende Platziergenauigkeit, sofortige betriebsbereit ohne lange Einstellungen
- Synchronisierte Steuerung aller relevanten Prozessparameter: Temperatur, Fluss, Zeit, Umgebung, Beleuchtung, Bild/ Video- Capturing
- Schnelle und einfache Prozessentwicklung
- Unmittelbares visuelles Feedback verkürzt Prozessentwicklungszeiten

Prozesse

- Bauteilentfernung
- Restlotentfernung
- Reballing (Array, Single Ball)
- Lotpastendruck (Bauteil, Board)
- Lotpasten- Dipping
- Lotpasten- Dispensen
- Fluxen
- Einlöten
- Auslöten

Anwendungen

- Löten von:
 - BGA, μ BGA/ CSP, QFN, PoP, QFP, PGA,
 - Kleine SMD- Widerstände bis 0201
 - RF- Shields, RF- Frames
 - Konnektoren, Stecker
 - Sub- Module, Daughter Boards
 - Flipchip (C4)
- Single Ball Rework

Technical Specifications

Placement accuracy:	10 μ m @ 3 sigma
Field of view (min) ¹ :	2.5 mm x 1.9 mm
Field of view (max) ¹ :	17.5 mm x 13 mm
Component size (min) ¹ :	0.25 mm x 0.25 mm
Component size (max) ¹ :	50 mm x 50 mm
Theta fine travel / resolution:	$\pm 4^\circ / 1.0^\circ$
X- travel / resolution:	380 mm / 0.64 μ m
Y- travel / resolution:	155 mm / 0.64 μ m
Z- travel / resolution:	8 mm / 0.8 μ m
Top Heating²:	
Power:	900 W
Temperature ramp rate:	1 K/ s - 50 K/ s
Flow range:	10 NI/ min - 70 NI/ min
Bottom Heating²:	
Power:	1400 W
Heated area (max):	330 mm x 170 mm
Flow range:	48 NI/ min

Module & Optionen

- Bauteilpräsentation
- Dispenser- Modul
- Lotabsaug- Modul
- Oberheizungsmodul
- Prozessgasumschaltung
- Prozess- Startsensor
- Prozessvideo- Modul
- Traceability- Modul
- Unterheizungsmodul

Notizen: